

**智原科技 2024 年第三季合併營收 28.8 億，EPS NT\$1.01****IP 及 NRE 營收雙雙創下單季新高紀錄****2024 年第三季合併財務報表摘要**

- 營業收入為新台幣 28.8 億元
- 毛利率為 46.4%
- 歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 2.6 億元
- 基本每股盈餘為新台幣 1.01 元

台灣·新竹 – 2024 年 10 月 29 日 – 智原科技 (TWSE: 3035) · ASIC 設計服務暨矽智財(IP)研發銷售領導廠商，今日公佈 2024 年第三季合併財務報表。第三季合併營收為新台幣 28.8 億元，較上季增加 9%，較去年同期下降 3%。第三季毛利率為 46.4%，歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 2.6 億元，基本每股盈餘為新台幣 1.01 元。

回顧第三季，三大產品別皆呈現季增趨勢，IP 及委託設計服務(NRE)營收雙雙創下單季新高，量產營收到向上軌道。IP 營收為新台幣 4.5 億，季增 29%，年增 35%，創下單季新高。委託設計服務為新台幣 6.5 億，季增 1%，年增 102%，再創單季新高紀錄；量產營收為新台幣 17.9 億元，季增 8%，年減 23%，第三季 ASIC 量產逐漸回溫，MCU 需求亦維持高檔，帶動量產營收較上季成長。毛利率受到產品組合影響較上季微幅下滑至 46.4%，營業費用較上季微幅增加，本季營業利益率較上季上升來到 10.7%，第三季基本每股盈餘為新台幣 1.01 元。今年對於智原來說是轉型年，不僅在製程技術上快速延伸至 2 奈米，更於先進封裝首創垂直分工的商務模式。智原透過整合源自不同供應商或半導體廠的小晶片來簡化整體先進封裝流程，建立先進封裝協作平台，為客戶統籌設計、封裝和生產等核心服務，智原獨家的商務模式不僅獲得客戶肯定，相關專案亦於近期成功進入量產，為公司在先進業務上立下新里程碑。

展望第四季，先進封裝專案進入量產階段開始貢獻營收，使得整體量產營收可望延續前一季成長動能。公司的核心業務隨著轉型逐漸擴大，智原的核心業務範疇從原先的成熟製程及 IP 兩個項目逐步拓展至六個項目，新增的四個項目包含先進製程、2.5D 封裝、3D 封裝及晶片實體設計服務(Design Implementation Service)，新增的業務範疇強化了公司競爭力及市場地位，同時也擴大公司的整體潛在市場(Total Accessible Market)。公司將在新的市場中透過彈性的商務模式持續放大先進業務的營收貢獻，期望為公司帶來更多商機及成長機會。

營運成果

營運成果

(金額: 百萬新台幣)	2024 年第三季	2024 年第二季	增(減) %	2023 年第三季	增(減) %
營業收入淨額	2,884	2,649	8.9	2,962	-2.6
營業毛利	1,338	1,249	7.1	1,281	4.4
營業費用	(1,029)	(992)	3.7	(853)	20.6
營業利益	309	257	20.3	428	-27.9
營業外收入及支出	44	83	-47.2	24	82.1
本期淨利(歸屬母公司業主)	264	261	1.2	354	-25.4
基本每股盈餘 (元)	1.01	1.00		1.42	

財務報告

營業成本、營業費用與營業外收入及支出

(金額: 百萬新台幣)	2024 年第三季	2024 年第二季	增(減) %	2023 年第三季	增(減) %
營業收入淨額	2,884	2,649	8.9	2,962	-2.6
營業成本	(1,546)	(1,400)	10.5	(1,681)	-8.0
營業毛利	1,338	1,249	7.1	1,281	4.4
毛利率 (%)	46.4%	47.1%		43.2%	
營業費用	(1,029)	(992)	3.7	(853)	20.6
營業利益	309	257	20.3	428	-27.9
營業利潤率 (%)	10.7%	9.7%		14.5%	
營業外收入及支出	44	83	-47.2	24	82.1

流動資產

(金額: 百萬新台幣)	2024.09.30	2024.06.30	2023.09.30
現金及約當現金	8,319	9,900	5,544
應收票據及帳款淨額	1,236	1,088	1,521
應收帳款週轉天數	47	46	43
存貨淨額	842	929	1,640
存貨週轉天數	64	69	124
流動資產合計	10,901	12,401	9,119

負債

(金額: 百萬新台幣)	2024.09.30	2024.06.30	2023.09.30
流動負債合計	3,888	4,468	3,770
應付票據及帳款	1,412	1,268	1,378
其他	2,476	3,200	2,392
非流動負債合計	1,019	697	370
負債總計	4,907	5,165	4,140
負債/權益比	36.3%	39.3%	44.4%

## 營收分析

### 委託設計營收（應用別）

應用	2024 年第三季	2024 年第二季	2023 年第三季
通訊網路	22.4%	8.9%	44.5%
行業用	62.7%	58.1%	25.4%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	3.6%	2.5%	10.3%
AIoT	11.3%	30.5%	19.8%

### 委託設計營收（製程技術別）

技術	2024 年第三季	2024 年第二季	2023 年第三季
≥0.25um	0.5%	0.2%	1.1%
0.11um~0.18um	2.0%	15.4%	8.9%
55nm~90nm	8.2%	9.2%	15.2%
40nm	11.9%	11.3%	20.6%
≤28nm	77.4%	63.9%	54.2%

### 量產營收（應用別）

應用	2024 年第三季	2024 年第二季	2023 年第三季
通訊網路	10.3%	8.8%	8.1%
行業用	28.0%	26.1%	52.8%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	6.4%	11.5%	7.7%
AIoT	55.3%	53.6%	31.4%

### 量產營收（製程技術別）

技術	2024 年第三季	2024 年第二季	2023 年第三季
≥0.25um	0.6%	1.1%	1.3%
0.11um~0.18um	7.5%	10.6%	36.4%
55nm~90nm	58.3%	58.1%	34.6%
40nm	21.4%	17.3%	15.0%
≤28nm	12.2%	12.9%	12.7%

### 總營收（產品別）

產品	2024 年第三季	2024 年第二季	2023 年第三季
量產	62.0%	62.6%	78.0%
委託設計服務	22.5%	24.4%	10.9%
矽智財	15.5%	13.0%	11.1%

## Contact

曾雯如  
財務長兼發言人  
+886-3-5787888

盧昭儀  
投資人關係  
+886-3-5787888 ext. 84588  
ir@faraday-tech.com

### 關於智原

智原科技（Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035）以提供造福人類、支持永續發展的晶片為使命，持續發展完整的 ASIC 解決方案，包含 2.5D/3D 先進封裝、Arm Neoverse CSS 設計、FPGA-Go-ASIC 與晶片實體設計服務。同時，智原擁有豐富的矽智財資料庫，涵蓋 I/O、Cell Library、Memory Compiler、ARM-compliant CPUs、LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100/Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、可程式設計高速 SerDes，及 PCIe Gen4/3 等數百個週邊訊號 IP。更多資訊，請瀏覽智原科技網站：[www.faraday-tech.com](http://www.faraday-tech.com) 或 [LinkedIn](#) 專頁。